發佈單位 ： 円星科技股份有限公司
發佈日期 ： 2026/11/6

# 円星科技 (M31)2026 年第三季線上法人說明會 Q&A 完整實錄

## 主講人：總經理 張原熏

Q1：請總經理說明 2026 年第四季的營運重點與主要成長動能。目前 EPS 仍為負數，是否能預測全年 EPS 範圍與支撐？是否調整本年度營收成長幅度？以及今年費用增幅是否會控制在 10% 以下？

答： 前三季累計 EPS 雖仍為負數，但公司營運在第四季通常會有較佳的發展與展現。目前目標與責任就是希望在第四季實現「倒吃甘蔗」，順利達成設定的營收目標。對今年全年 EPS 轉為正數抱持信心，團隊正全力朝此方向推進。
在新製程專案方面，隨著業務重心更聚焦於先進製程，客戶對各專案決策的時間確實拉得較長。但在北美晶圓廠、Fabless 客戶以及全球生態系夥伴的合作帶動下，預期今年全年營收仍能比去年成長，並務必達成全年 EPS 轉正的目標，同時延續動能至明年，讓權利金如期展開，成為營運回升的轉折點。

Q2：第三季實現單季轉虧為盈後，第四季能否延續獲利？本次轉盈是一次性的表現，還是 M31 真正的營運轉折？

答： 過去在先進技術上的研發投入已開始看到成果，後續關鍵在於權利金的累積是否能成為公司長遠成長的基石。若要達成全年 EPS 轉正的目標，第四季勢必需要延續單季獲利的表現。隨著先進製程權利金規劃於明年逐步發揮效益，將為營運奠定良好基礎。目前已具備營運轉折的契機，期望自明年起能夠展現更穩健的營運成績。

Q3：請總經理說明 2027 年及 2028 年的營運展望（包含營收成長、營業利益率、費用控制規劃以及獲利能力發展方向）。

答： 過去長期布局的先進製程權利金，預計在 2027 年與 2028 年迎來顯著的收成期。目前正密切追蹤 2 奈米、3 奈米及 4 奈米/5 奈米專案客戶邁入量產的進度，整體看法樂觀，預期 2027 至 2028 年營運成果將逐步攀升。
在研發費用與人力控管方面，過去兩年因 EDA 工具授權及人員擴充導致費用增幅較大，今年起已開始實施控制。目標是將每年的費用增幅控制在約 10%（或略高於 10%）的水平，同時將全球總人數維持在大約 400 人的規模。隨著營收規模成長與費用有效控管，營業利益率將可望逐步拉升。

發佈單位 ： 円星科技股份有限公司
發佈日期 ： 2026/11/6

Q4：請分享對公司整體授權金與權利金成長的看法、預估成長幅度與營收占比，以及 2027 年成長動能來自哪些製程節點？上下半年營收節奏如何分布？

答： 展望未來營收結構，目標是授權金維持約 10% 的年成長率，而權利金部分則期望挑戰 30% 以上的顯著成長，以帶動更健全的營收結構與獲利品質。
在製程節點方面，成長動能將全面集中於 16 奈米以下的先進製程與泛先進製程。公司亦將持續透過導入 AI 技術來提高研發產出效率與減少出錯率，藉此優化營業利益率。
在上下半年營收分布方面，預計仍會呈現下半年高於上半年的趨勢，但目標是讓節奏更加平衡健康，朝上下半年 45:55 的營收比重邁進。

Q5：2 奈米相關專案進展如何？目前在台積電 N2/GAA 平台的客戶導入和開案情況是否符合預期？

答： 2 奈米屬於半導體金字塔頂端的製程，市場上有能力採用該製程的客戶數量相對有限。但好消息是公司的領導客戶已持續採用 2 奈米甚至更先進的 A14 平台進行開案，且在台積電之外的其他晶圓廠亦有 2 奈米相關斬獲。
針對極先進製程（2nm 及以下），公司的開案模式與以往「先開發大量 IP 再等客戶採用」不同，而是改採與領導客戶前瞻共研/前期合作（Engage/Co-development）的模式。依據客戶實際需求與驗證節奏共同開發，能精準控管開發費用，避免盲目投入大量 IP 研發資源。

Q6：先前法說會提到北美 2 奈米 IC 設計大廠專案預計於今年底至明年初開始貢獻權利金，目前進度是否符合預期？

答： 實際時程仍需視客戶進入量產的具體節奏而定。目前已知客戶已積極準備進入量產階段，非常期待最快於 明年初（2027 Q1） 開始看見該專案的權利金貢獻。

Q7：考量目前有多個 2nm、3nm 及 A14 專案推進，2027 年是否為先進製程權利金邁向收成期的重要轉折點？對營業利益率的改善幅度為何？

答： 若先進製程專案如預期推進並隨客戶量產持續累積，2027 年確實會是權利金顯著進帳並邁入收成期的重要轉折點。隨著高毛利的權利金營收占比拉高，將會對公司的營業利益率帶來非常顯著且正面的改善效益。

發佈單位 ： 円星科技股份有限公司
發佈日期 ： 2026/11/6

Q8：隨著 AI 推論與客製化晶片需求增加，M31 在 AI 時代的商機為何？近期是否有 AI 夥伴或產品開發？AI 營收占比大概是多少？

答： 目前公司所有新導入與洽談中的客戶專案，事實上均與 AI 應用密切相關，AI 已深入至各類晶片設計中。即使是在成熟製程（例如 22nm），客戶亦會在晶片中導入小型語言模型並對低功耗提出強烈需求。
特別是在人形機器人與智慧終端裝置（Smart Connectivity）領域，對低功耗與高速傳輸 IP 的需求顯著增加，AI 將會是推動公司未來營收成長的核心驅動力。

Q9：市場傳出有同業取得數千萬美元規模的 2 奈米 AI 專案，公司是否有參與相關商機？在爭取 2 奈米大型專案時面臨哪些挑戰？未來是否能爭取大型 IC 設計公司的案件？

答： 純 IP 授權與 ASIC（客製化晶片）的商業模式與收費結構有所不同，IP 具備高度重複利用與長期發酵的特性。
隨著晶片進入 2 奈米以下極先進製程，開案規模龐大且高度依賴先進封裝，客戶大多為大型 IC 設計公司。M31 除了持續穩固中小型客戶（螞蟻雄兵）基礎外，也已成功切入大型行動晶片與高階網通大廠的先進製程合作。在台積電 OIP 上，Broadcom 曾分享如何從 Follower 轉變為 Early Adopter，這也是 M31 努力的方向。公司將持續深化與晶圓廠及大型客戶的合作，提供高穩定性的 IP 解決方案。

Q10：請總經理分享 6 奈米及更先進製程的接案狀況、產品應用與客戶地區性質，以及光通訊或 AI 伺服器專案的最新進展？

答： 在 6 奈米及更先進製程平台方面，市場需求非常強勁，廣泛應用於高速儲存、邊緣 AI 及人形機器人相關晶片。
在光通訊與 AI 伺服器領域，公司正積極佈局點對點 SerDes（如 PCIe 6.0 64G、112G） 連接技術與光訊模組 IP，並關注 CPO（共同封裝光學）中的 OCI（Optical Circuit Interface） 技術。此外，由於 AI 伺服器與高效能運算晶片對 SRAM 的需求極大，公司正強化客製化 SRAM 的開發能力，以滿足市場對高傳輸與客製化記憶體的龐大需求。